

全自動包裝系統

FOUP / FOSB / POD / REEL / TRAY / HWS / Frame Cassette / Mask Box



包裝前



包裝後



包裝前



包裝後

- 適用產業:半導體晶圓製造、封裝、測試等產業
- 適用拆包場合: 8 & 12 吋晶圓之出貨及廠間製程轉移皆適用
- 適用於 FOUP、FOSB、POD、REEL、TRAY、HWS、Frame Cassette、Mask Box
- 適用包裝袋種類:鋁袋、抗靜電袋、透明袋; 單層、雙層
- 主要功能:
 - 標籤貼覆:將標籤貼覆於包裝袋上
 - 自動貼標/HIC 卡放置/乾燥劑放置
 - 自動抽真空熱封
 - 自動折袋與貼膠

全自動拆包系統

FOUP / FOSB / POD / REEL / TRAY / HWS / Frame Cassette / Mask Box

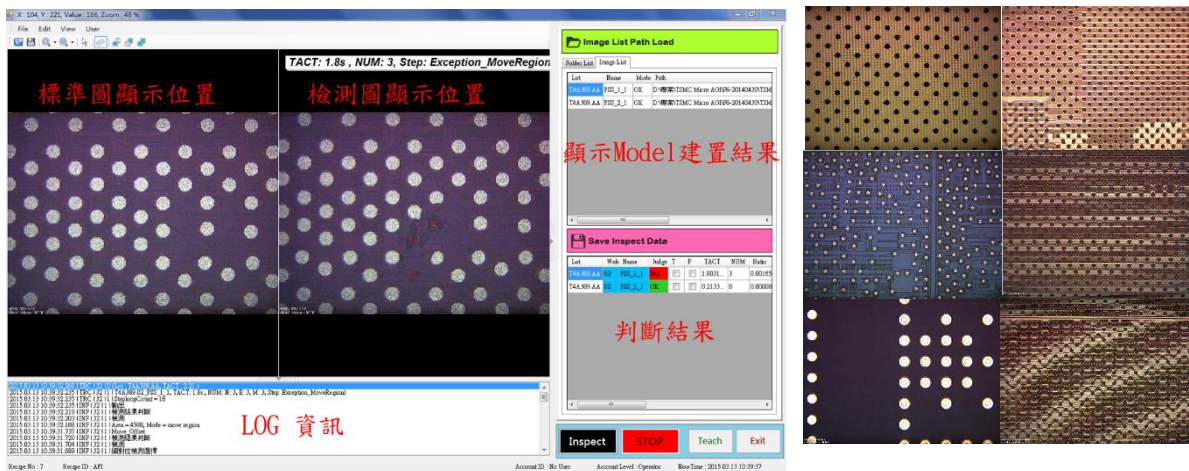


拆包前



拆包後

- 適用產業:半導體晶圓製造、封裝、測試等產業
- 適用拆包場合: 8" & 12" 晶圓入料及廠區間轉移
- 適用於 FOUP、FOSB、POD、REEL、TRAY、HWS、Frame Cassette、Mask Box
- 適用晶圓盒(FOUP)尺寸: W415*D330*~360*H335mm
- 適用包裝袋種類:鋁袋、抗靜電袋、透明袋; 單層、雙層
- 主要功能:
 - 拆袋:將 FOUP 外的單雙層袋拆離
 - 乾燥劑:將乾燥劑回收至集中桶內
 - 廢袋集中:將廢袋收回集中桶槽
 - 連結系統:結合包裝機與 ASRS Docking



- 適用產業:半導體晶圓製造、封裝、測試等產業
- 適用檢驗場合: 8" & 12" 晶圓入出料(正背檢)表面檢驗
- 適用於 Wafer Surface Defect、Scratch、Particle、Crack、Chipping....
- 適用晶圓尺寸:200mm、300mm Wafer
- 主要功能:Wafer Defect、Notch Align、Wafer Code Scan (OCR)、Detect Thickness